

中信证券股份有限公司
关于贵州振华风光半导体股份有限公司
2025 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 8 月 21 日对公司进行了募集资金半年度现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、公司出具的 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

1. 研发未达预期风险

公司围绕市场需求，开展核心技术研发、新产品拓展、技术升级改造等工作，投入了大量的资金和人力，公司技术成果的产业化和市场化进程具有不确定性，如果在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入无法收回且难以实现预计效益的风险，并将对公司业绩产生不利影响。

2. 研发人员不足或流失的风险

集成电路行业是技术密集型行业，关键技术和人才是公司保持持续竞争优势的基础，随着技术研发的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时加大对高端、复合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，或者出现研发人员流失的情况，都将会导致公司的竞争力下降。

3. 客户集中度较高风险

报告期内，由于公司下游客户主要以央企及其下属单位为主，使得公司以同一集团合并口径的客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户形成了密切配合的

合作关系，按照特种元器件供应的体系，通常定型产品的供应商不会轻易更换，且公司积极研发满足现有客户需求的新产品、积极拓展新客户、开拓新市场，减少客户集中度高的潜在不利影响。但若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

4.应收账款及应收票据余额较高的风险

报告期公司业务规模不断扩大，应收账款的余额相应增长。由于特种领域产品验收程序严格和复杂，同时受客户主要以商业票据结算为主的影响，导致公司应收账款、应收票据的规模较大。虽然公司客户主要为央企及其子公司，整体信誉较好，支付能力较强，但若公司不能有效提高应收票据及应收账款管理水平及保证回款进度，将有可能出现应收票据及应收账款持续增加、回款不及时甚至坏账的情形，从而对公司经营成果造成不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化应收账款回款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

5.存货金额较大及发生减值风险

随着公司业务规模的不断扩大，为满足生产经营需要，公司存货相应增加。受产品种类型号多、验收程序繁琐等因素的影响，公司储备的原材料较大，客户尚未验收的发出商品余额较大，导致存货余额较高。同时，公司积极应对客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期客户的需求，对部分产品提前备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将增加因存货周转率下降导致计提存货跌价准备的风险。

风险管理措施：一方面公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制，同时加强销售队伍建设，不断完善客户需求分析管理体系，合理备货；另一方面严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

6.行业风险

(1) 需求端的放缓或调整，引起市场竞争格局变化，价格成本控制更加敏感，供应链的稳定性和需求预测变得更加重要。

(2) 下游需求及产品销售价格波动风险，如未来受行业环境因素的影响，如果高可靠集成电路的下游市场需求出现一定波动，或者因市场竞争加剧导致产品销售价格有所下降，从而对公司销售收入及毛利率等经营业绩指标造成不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025年1-6月	2024年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	46,465.74	61,056.89	-23.90
归属于上市公司股东的净利润	6,237.38	23,129.64	-73.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,190.16	21,685.61	-76.07
经营活动产生的现金流量净额	16,627.22	-4,584.16	不适用
主要会计数据	2025年6月末	2024年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	495,532.45	492,555.07	0.60
总资产	552,771.05	548,218.92	0.83
主要财务指标	2025年1-6月	2024年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3119	1.1565	-73.03
稀释每股收益(元/股)	0.3119	1.1565	-73.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2595	1.0843	-76.07
加权平均净资产收益率(%)	1.26	4.80	减少3.54个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.05	4.50	减少3.45个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.57	11.68	增加4.89个百分点

(1) 营业收入同比下降 23.90%，主要系报告期内，受特种集成电路产品持续降价销售影响，导致本期主要产品销量维持稳定但营业收入同比下降。

(2) 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 73.03%和 76.07%，主要原因：一是受国内特种领域产品持续降价的影响，产品销量基本持平，使得产品销售毛利率同比下降；二是应收款项增加，计提的信用减值损失增加。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 21,211.38 万元，主要原因：一是公司加强货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；二是公司持续优化生产计划，优化生产管理系统，减少存货占用时间，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；三是本期营业收入及利润总额同比下降，支付的增值税和企业所得税同比减少。

(4) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别下降 73.03%、73.03%和 76.07%，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。

(5) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别下降 3.54 个百分点、3.45 个百分点，主要系报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司的核心竞争力

1.研发方面

作为国内模拟集成电路产业先驱企业，公司始终以国产化需求与技术自主创新为双轮驱动，持续强化研发投入及技术体系升级。依托自主构建的集成电路研

发设计平台，已形成覆盖模拟、数模混合及系统集成领域的技术储备，产品谱系持续扩展。

在研发模式上，构建贵阳、成都、西安、南京、上海五地协同的“多中心研发网络”，同步深化与复旦大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学等顶尖高校的产学研融合，通过共建联合实验室及专项合作，加速科技创新成果转化。

在研发流程上，具备完整的集成电路前后端设计能力，工艺平台覆盖 Bipolar、CMOS、BiCMOS、BCD、抗辐照双极工艺、GaAs 等主流工艺，支持 $4\ \mu\text{m}\sim 28\ \mu\text{m}$ 制程节点；基于自主开发器件模型库实现极限工况的精准设计，掌握超大规模 ASIC（千万门级）、SIP 系统封装、RISC-V 架构 MCU 及国产化 SoC 的解决方案，实现从芯片设计、封装测试、辐照验证到算法建模的全流程自主可控。积极与成都、广州、上海、苏州、深圳、重庆等地的多家知名企业及科研机构开展技术研究、协同创新等合作，实现优势互补、资源共享的集成电路产业生态链。

在研发平台上，建成超大规模异地协同计算集群，支持：模拟/数模混合/数字集成电路全流程仿真验证、海量迭代数据存储与并行计算任务调度、400 人级并发在线协同设计。

2.制造能力方面

公司具备厚膜陶瓷基板、气密性产品、塑封产品及 SMT 规模化生产能力。提供从晶圆到成品的全流程封装解决方案，涵盖产品的电、热、结构及可制造性设计与仿真，支持 6 吋~12 吋晶圆加工服务、CDIP/CLCC/CBGA 等多品种陶瓷封装服务、金属腔体/金属圆柱/金属法兰等多品种金属封装服务、SOP/SOT/QFP/BGA 等高可靠塑封服务，以及 FCBGA/BGA/SiP 等系统级封装服务。产品可靠性覆盖 B/H 级至 S 级/K/N1 级标准，可为客户提供高频、高导热的定制化封装服务。

3.测试能力方面

公司基于 V93K 采用加窗算法和主瓣 bin 计算基波功率的创新性解决方案，实现 22 位 ADC 转换器的信噪比/谐波失真精确测试，建成 300V/100A 大功率驱

驱动器测试平台和攻克三相无刷电机驱动器功能参数全覆盖测试，突破放大器 0.95nV/Hz 的超低电压噪声特性指标测试，围绕公司多方向产品体系，攻克 0.02° 分辨率的磁编码测试，搭建 40GHz 的射频微波测试平台，32 位 MCU 测试平台建设取得关键进展，解决温度系数 5ppm、电压精度 0.03% 的电源类产品测试难题。依托上述核心技术突破与自主创新能力，公司构建起覆盖多领域、多场景的完整测试体系，形成以高精度、宽频段、全品类适配为特色的核心竞争力，为行业客户提供从芯片级到系统级的全栈式测试解决方案。

4.质量管理能力方面

公司在 GJB9001C 质量管理体系的基础上，深化新时代质量管理体系建设，并且获得 3 级认定，在高可靠元器件行业质量管理水平国内领先，公司高度重视产业链管理，以协同全产业链质量管理模式向行业推广应用，同时公司顺利通过 IATF16949 质量管理体系认证，标志着公司在汽车领域元器件产品的技术和质量管理标准获得行业认可。报告期内，为适应公司发展需求，新增 AS9100《质量管理体系——航空、航天和防务组织要求》的认证；GJB9001C 质量管理体系增加了 8 个类别产品的扩项，包括：单片驱动器、电源管理电路、数据转换器、信号开关电路、信号调理、存储器、微处理器、微组装电路等产品的科研、生产、技术服务，拓展了公司产品许可门类；贯标线新增陶瓷封装产品的认证；在深化新时代质量管理体系建设时，统筹策划四级建设的方案，查找四级信息建设的差距，进一步推进公司数字化建设。公司积极开展质量改进，其中 3 个成果获 2025 年度贵州省省特级 QC 成果。

5.市场方面

作为国内模拟集成电路研发和生产的先行者，公司持续深耕高可靠电子产业，通过丰富产品矩阵、升级制造工艺、严控质量体系，在多个细分领域占据主导地位。相较同业，公司在服务响应、应用经验等方面具备显著优势。在市场拓展方面，报告期内推出新产品 60 余项，深化用户导向战略，销售网络覆盖七大片区 15 个网点，60 余名营销与 FAE 团队驻地服务，实现全领域高效覆盖。公司的信号链产品长期领跑市场，广泛应用于无人机、无人艇、商业航天、商飞（试样）及低成本装置等新兴领域。

为强化竞争力，公司创新构建“客户-方案-交付”的三角营销模式，整合FAE/AE团队聚焦新品推广与新市场开发，报告期内引进新需求75项。公司通过联合开发、系统级解决方案（模块/模组/板卡）实现配套升级与选型主导权。核心客户采用“销售+FAE”二对一机制深度挖掘需求，并依托中国振华获取优先交付及结算权益。同步加速布局国际化、商业航天、车规电子、民用装备等新赛道。

6.人才方面

公司高度重视人才队伍建设，持续优化人才管理机制，为业务发展提供有力支撑。截至本报告期末，公司总人数（含子公司）849人，较上年同期增长1.2%。其中研发人员261人，研发人员占公司总人数（含子公司）比例为30.74%。公司通过市场化引才、校企合作（如哈尔滨工业大学、复旦大学、电子科技大学等高校）及关键人才激励，加大薪酬激励力度，强化“引育用留”体系；同时依托分类培训、项目实践等方式提升团队能力，致力于打造专业化、高素质队伍，助力长期战略目标的实现。

7.企业文化

公司围绕“拼搏奉献、担当务实、创新发展、卓越共赢”的核心价值导向，着力塑造积极向上的企业文化，引导员工将“科技为先、质量为本、用户至上、诚信共赢”的经营理念融入日常实践。以人为本是公司的管理基石，员工不仅是文化建设的主角，更是公司最宝贵的资源。通过持续激发员工的积极性与创造力，公司致力于实现“百年风光梦，幸福风光人”的愿景，推动员工价值升华和企业蓬勃发展和谐统一。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	7,698.37	7,129.41	7.98
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	7,698.37	7,129.41	7.98
研发投入总额占营业收入比例(%)	16.57	11.68	4.89
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

2025年1-6月，公司研发投入总额占营业收入的比例为16.57%，同比增加4.89个百分点，研发投入总额较上年同期未发生重大变化。

（二）研发进展

报告期内，公司在集成电路设计领域，申请发明专利30件、实用新型专利1件、集成电路布图设计67件；在集成电路封测领域，申请发明专利5件、软件著作权4件。

报告期内获得的知识产权列表：

类型	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	30	3	169	49
实用新型专利	1	0	90	86
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	4	4	11	11
其他	67	60	285	275
合计	102	67	555	421

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅

募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度相比原计划有所延后，公司已审议通过募投项目延期的议案，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有公司 40.12%的股份。公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，其通过持有中国电子有限公司与中国振华股权间接控制振华风光 40.12%的股份，并通过中电金投间接控制振华风光 2.92%的股份，合计控制振华风光 43.04%的股份。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接持有公司股票，通过员工持股平台贵州风光智管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风光智”）及贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“风光芯”）间接持有公司股票情况如下：

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	质押或冻结情况
1	朱枝勇	董事长	无	无质押或冻结
2	赵晓辉	副董事长	通过风光智间接持有公司 0.079%的股份	无质押或冻结
3	胡锐	董事、总经理、核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.063%的股份	无质押或冻结
4	刘宗永	总法律顾问	通过风光芯间接持有公司 0.063%的股份	无质押或冻结

序号	姓名	任职情况	间接持股情况	质押或冻结情况
5	刘岗岗	副总经理	通过风光芯间接持有公司 0.063%的股份	无质押或冻结
6	唐拓	副总经理	通过风光智间接持有公司 0.063%的股份	无质押或冻结
7	段方	副总经理	通过风光智间接持有公司 0.043%的股份	无质押或冻结
8	刘健	副总经理	通过风光芯间接持有公司 0.063%的股份	无质押或冻结
9	张博学	董事会秘书、 总会计师	通过风光芯间接持有公司 0.020%的股份	无质押或冻结
10	李政	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.034%的股份	无质押或冻结
11	李平	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.025%的股份	无质押或冻结
12	唐毓尚	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.047%的股份	无质押或冻结
13	夏良	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.017%的股份	无质押或冻结
14	李雪	核心技术人员	通过风光智间接持有公司 0.017%的股份	无质押或冻结

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

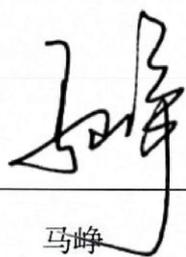
公司募投项目之高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目的建设进度相比原计划有所延后。公司已审议通过募投项目延期的议案，同意将上述项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。保荐人提请公司有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

除上述事项外，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

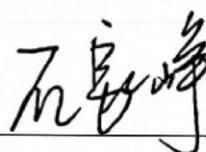
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司 2025 半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



马峥



石家峥

